

电子工艺基础

第2版

王卫平 主编

<http://www.phei.com.cn>



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

电子工艺基础

(第2版)

王卫平 主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书是根据国家大力恢复工业制造业、教委关于推动高校生产实习基地建设、提高生产实习教学质量的文件精神编写的。本书从电子整机产品制造工艺的实际出发，介绍常用电子元器件和材料、印制电路板的设计与制作、表面安装技术、整机的结构及质量控制、生产线的组织与管理等。全书共9章，每章均附有思考与习题。通过学习这些内容，有助于读者掌握生产操作的基本技能，又能够站在工艺工程师和工艺管理人员的角度认识生产的全过程，充分了解工艺工作在电子产品制造过程中的重要地位。

本书可以作为高等院校电子类专业及相关专业的教材或教学参考书，也可供电子产品制造企业的工程技术人员和那些正在申请ISO 9000国际质量管理体系标准认证和3C认证的单位参考。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

电子工艺基础/王卫平主编. —2 版. —北京：电子工业出版社，2003.9

ISBN 7-5053-9182-8

I. 电… II. 王… III. 电子技术—高等学校—教材 IV. TN

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 084909 号

责任编辑：刘海艳 E-mail:lhy@phei.com.cn

印 刷：北京东光印刷厂

出版发行：电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销：各地新华书店

开 本：787×1092 1/16 印张：22.5 字数：576 千字

版 次：2003 年 9 月第 2 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数：5 000 册 定价：29.00 元

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系。联系电话：(010) 68279077。质量投诉请发邮件至 zts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

前　　言

20世纪90年代以来，以“3C”——计算机(Computer)、通信(Communication)和家用电器等消费类电子产品(Consumer Electronics)为代表的IT(信息技术，Information Technology)产业的迅猛发展，无论是它为社会进步所发挥的技术作用以及它创造的产值和利润，还是它所提供的劳动力就业机会，都使其在国民经济中的作用和地位更加重要。如果说，美国的硅谷是全世界IT产业的研发基地，那么，以港台和我国东南沿海为代表的东南亚则是全世界电子产品的生产基地。并且，随着经济一体化的进程，被称为OEM(原始设备生产，Original Equipment Manufacture)的生产方式成为电子产品加工的重要模式之一。现在，港台厂商纷纷把工厂搬到我国沿海地区，在大陆加工生产并出口到世界各地的电子产品已经占有很大的份额。中国将成为世界现代化工业加工厂的局面已经初见端倪。近来，我国政府明确指出，现代化就是工业化。在我国大力推动现代化的过程中，制造业应该起到基础性、支柱性产业的作用。在恢复发展我国制造业的过程中，用信息技术改造传统产业，以信息化带动工业化，大力发展战略性新兴产业、机电一体化和自动化产业。这种局面要求我们的大学工科教育必须向社会提供具有现代电子工业知识和技能的工程技术人员。

在最近十年里，全世界电子产品的硬件装配生产已经全面转变到以SMT(表面安装技术，Surface Mounting Technology)为核心的第四代工艺，一切生产过程管理则必须遵从以ISO 9000系列质量管理体系标准和ISO 14000系列环境管理标准为代表的现代化科学管理模式。在我国已经进入WTO的今天，不仅国家的宏观经济要与国际“接轨”，我们培养的工程技术人才及从业劳动者的素质和技能也必须符合行业的需求。

国家教委在几年前就提出了大力发展高等职业教育的要求，大部分中专、大专院校已经调整转变为高等职业教育院校，培养应用型技术人才的宗旨已经被社会普遍接受。为此，国家和高校投资建设的各种实训基地纷纷建立，为高等职业技术教育编写的系列教材广泛发行。高等职业教育已经成为我国教育体制改革的热点和突破口。

本书是对1997年出版的《电子工艺基础》的修订版，原书已经多次印刷，受到各方面读者的好评。但随着电子工业的发展和教学的需求，原书所涉及的许多内容也略显陈旧。现在，电子工业出版社决定出版本书的修订版，无疑是符合电子工艺技术的发展和人才市场对工程技术人员的要求的。其实，就本书所涉及的内容而言，它的读者对象不应该仅限于高职和这一层次的技术人员，对于电子技术应用类的本科毕业生来说，不了解电子产品生产过程的每一个细节，不理解生产工人操作的每一个环节，就很难设计出具有生产可行性的产品。毫无疑问，对电子工艺技术的真知灼见将有助于原理性设计的成功。日本丰田汽车的创始人丰田喜一郎有一句名言：“技术人员不了解现场，产品制造就无从谈起。”他的这一观点，应该对每一个电子工程技术人员有所启迪。

关于工程工艺类教学还有一个问题，即我们的教育似乎总是落后于社会的需求。这里不仅有目前高校工程工艺实训环境和设备的限制，还因为部分实验教师本身就缺乏工程实践的经历和经验，在某些院校里电子工艺实训还处于探索阶段。近年来的商业、服务业经济发展对工业制造业形成了一定程度的冲击。在很多企业中，劳动者的平均技术素质不高，甚至出

现有经验的高级技术工人奇缺的局面。因此，从事高等院校工科教育的教师们应该深入思考，研究改革我们的教育体制、体系、模式和方法，适应现代化和工业化对工程技术人才培养的需求。

上述背景和思考要求我们在本书中突出第四代电子产品的装配生产工艺 SMT 和现代化生产过程及质量管理思想，用前瞻和发展的眼光去选择与修订本书的内容和素材。考虑到自动化 SMT 设备一般非常昂贵，高校现有的实训基地大都不具备 SMT 工艺的条件和设备，书中将从第三代电子产品的通孔基板插装 (THT) 工艺出发，仔细描述 SMT 的特点及其与 THT 的差别，介绍一些切实可行的手工处理 SMT 的方法，供有条件的实训基地参考安排培训内容，让读者学习体会并尝试自己动手。

由于在实际工艺中，电路中的元器件仍沿用旧有标注习惯，故本书中的标注没有能够与国标一致。按照国家标准，图中所有没有标注单位的长度数值，其单位都是毫米。

本书由王卫平主编，俞洪、金忆、许启军参加编著，俞洪负责修订第 1、3、6、7、8 章，金忆负责修订第 2、4、5、9 章，许启军负责对全部插图进行审核、增补和修改，由王卫平再次修订并统编全稿。本书在修订、编写的过程中，得到了余问是、陈贻昆等多位专家、领导的指导和帮助，北京联合大学师范学院电子信息系刘逍逍、赵玥、张颖、孙华、顾晶晶、李娜、梁缘、董亚婵、王赟、兴航、杨建潇、郑涛、赵伟、王郁松、贾建平等同学参加了全部图稿的绘制工作，提供并参加整理资料的还有莫淑梅、王小茉，在此一并致谢。

由于电子工艺技术发展极快，编者的经验和经历有限，本书肯定会有许多不足之处，欢迎批评指正。

编 者

2003 年 7 月

目 录

第1章 电子工艺技术和工艺管理	(1)
1.1 工艺概述	(1)
1.1.1 工艺的发源与定义	(1)
1.1.2 电子工艺学的特点	(2)
1.1.3 我国电子工艺现状	(3)
1.1.4 电子工艺学的教育培训目标	(5)
1.2 电子产品制造工艺工作程序	(5)
1.2.1 电子产品制造工艺工作程序图	(5)
1.2.2 产品预研制阶段的工艺工作	(7)
1.2.3 产品设计性试制阶段的工艺工作	(7)
1.2.4 产品生产性试制阶段的工艺工作	(13)
1.2.5 产品批量生产(或质量改进)阶段的工艺工作	(14)
1.3 电子产品制造工艺的管理	(15)
1.3.1 工艺管理的基本任务	(15)
1.3.2 工艺管理人员的主要工作内容	(15)
1.3.3 工艺管理的组织机构	(17)
1.3.4 企业各有关部门的主要工艺职能	(17)
1.4 电子产品工艺文件	(18)
1.4.1 工艺文件的定义及其作用	(18)
1.4.2 电子产品工艺文件的分类	(19)
1.4.3 工艺文件的成套性	(20)
1.4.4 电子工艺文件的计算机处理及管理	(20)
思考与习题	(22)
第2章 电子元器件	(23)
2.1 电子元器件的主要参数	(24)
2.1.1 电子元器件的特性参数	(24)
2.1.2 电子元器件的规格参数	(25)
2.1.3 电子元器件的质量参数	(29)
2.2 电子元器件的检验和筛选	(33)
2.2.1 外观质量检验	(33)
2.2.2 电气性能使用筛选	(34)
2.3 电子元器件的命名与标注	(35)
2.3.1 电子元器件的命名方法	(36)
2.3.2 型号及参数在电子元器件上的标注	(36)

2.4 常用元器件简介	(38)
2.4.1 电阻器	(38)
2.4.2 电位器(可调电阻器)	(46)
2.4.3 电容器	(50)
2.4.4 电感器	(59)
2.4.5 开关及接插元件	(63)
2.4.6 继电器	(69)
2.4.7 半导体分立器件	(73)
2.4.8 集成电路	(77)
2.4.9 在系统可编程逻辑器件	(83)
思考与习题	(89)
第3章 电子产品装配常用工具及材料	(92)
3.1 电子产品装配常用五金工具	(92)
3.1.1 钳子	(92)
3.1.2 改锥	(93)
3.1.3 小工具	(94)
3.2 焊接工具	(95)
3.2.1 电烙铁分类及结构	(95)
3.2.2 烙铁头的形状与修整	(99)
3.3 焊接材料	(101)
3.3.1 焊料	(101)
3.3.2 助焊剂	(104)
3.4 常用导线与绝缘材料	(106)
3.4.1 导线	(106)
3.4.2 绝缘材料	(109)
3.5 其他常用材料	(111)
3.5.1 电子安装小配件	(111)
3.5.2 粘合剂	(112)
3.5.3 常用金属标准零件	(113)
思考与习题	(114)
第4章 印制电路板的设计与制作	(115)
4.1 印制电路板的排版设计	(115)
4.1.1 设计印制电路板的准备工作	(116)
4.1.2 印制电路板的排版布局	(123)
4.2 印制电路板上的焊盘及导线	(129)
4.2.1 焊盘	(129)
4.2.2 印制导线	(131)
4.2.3 印制导线的抗干扰和屏蔽	(132)

4.3	板图设计的要求和制板工艺文件	(135)
4.3.1	板图设计	(135)
4.3.2	制板工艺文件	(136)
4.4	印制电路板的制造工艺简介	(137)
4.4.1	覆铜板的材料及其技术指标	(137)
4.4.2	印制电路板制造过程的基本环节	(139)
4.4.3	印制板生产工艺	(144)
4.4.4	多层印制电路板	(146)
4.4.5	挠性印制电路板	(148)
4.4.6	印制板检验	(149)
4.5	印制电路板的计算机辅助设计	(150)
4.5.1	用 CAD 软件设计印制板的一般步骤	(150)
4.5.2	印制电路板 CAD 典型软件简介	(151)
4.6	手工自制印制电路板	(155)
4.6.1	漆图法	(155)
4.6.2	贴图法	(156)
4.6.3	铜箔粘贴法	(156)
4.6.4	刀刻法	(156)
	思考与习题	(157)
第 5 章	装配焊接及电气连接工艺	(160)
5.1	安装	(160)
5.1.1	安装的基本要求	(160)
5.1.2	集成电路的安装	(163)
5.1.3	印制电路板上元器件的安装	(165)
5.2	焊接技术	(167)
5.2.1	焊接分类与锡焊的条件	(167)
5.2.2	焊接前的准备	(169)
5.2.3	手工烙铁焊接技术	(171)
5.2.4	焊点质量及检查	(175)
5.2.5	手工焊接技巧	(179)
5.2.6	拆焊	(182)
5.2.7	电子工业生产中的焊接简介	(184)
5.3	绕接技术	(186)
5.3.1	绕接机理及其特点	(187)
5.3.2	绕接工具及使用方法	(187)
5.3.3	绕接点的质量	(189)
5.4	其他连接方式	(189)
5.4.1	粘接	(189)

5.4.2 铅接	(191)
5.4.3 螺纹连接	(191)
思考与习题	(194)
第6章 表面安装技术 (SMT)	(196)
6.1 表面安装技术概述	(196)
6.1.1 表面安装技术的发展过程	(196)
6.1.2 SMT 的装配技术特点	(198)
6.2 表面装配元器件	(199)
6.2.1 表面装配元器件的特点	(199)
6.2.2 表面装配元器件的种类和规格	(199)
6.3 SMT 装配方案和生产设备	(206)
6.3.1 SMT 装配方案	(207)
6.3.2 SMT 元器件贴片机	(209)
6.3.3 手工贴装	(214)
6.3.4 SMT 维修工作站	(215)
6.3.5 SMT 焊接设备	(215)
6.4 SMT 印制电路板及装配焊接材料	(223)
6.4.1 SMT 印制电路板	(223)
6.4.2 膏状焊料	(236)
6.4.3 SMT 所用的粘合剂	(237)
6.4.4 清洗工艺	(240)
6.5 SMT 组件的返修	(241)
6.5.1 对返修工作的要求与条件	(241)
6.5.2 SMT 电路板的返修过程	(246)
6.6 电子组装技术简介	(246)
6.6.1 基片	(247)
6.6.2 板载芯片 (COB) 技术	(248)
6.6.3 带自动键合 (TAB) 技术	(248)
6.6.4 倒装芯片技术	(249)
6.6.5 厚/薄膜集成电路技术	(249)
6.6.6 大圆片规模集成电路 (WSI) 技术	(250)
思考与习题	(250)
第7章 电子产品的整机结构与电子工程图	(252)
7.1 电子产品的整机结构	(252)
7.1.1 机箱结构的方案选择	(253)
7.1.2 操作面板的设计与布局	(255)
7.1.3 电子机箱的内部结构	(259)
7.1.4 环境防护设计	(261)

7.1.5 外观及装潢设计	(265)
7.2 电子工程图简介	(266)
7.2.1 电子工程图概述	(266)
7.2.2 电子工程图中的图形符号及说明	(268)
7.2.3 产品设计图	(272)
7.2.4 工艺图	(280)
思考与习题	(288)
第8章 电子产品生产线及产品的环境试验	(290)
8.1 电子产品生产线	(290)
8.1.1 生产线的总体设计	(290)
8.1.2 电子产品生产工艺过程举例	(296)
8.1.3 电子产品的计算机集成制造系统 (CIMS)	(299)
8.2 电子产品的调试	(301)
8.2.1 调试工艺方案	(302)
8.2.2 整机产品调试的步骤	(302)
8.2.3 调试中查找和排除故障	(305)
8.3 电子整机产品的老化和环境试验	(309)
8.3.1 整机产品的老化	(310)
8.3.2 电子整机产品的环境试验方法	(310)
思考与习题	(312)
第9章 电子产品的质量管理	(314)
9.1 质量和可靠性的基本概念	(314)
9.1.1 质量	(314)
9.1.2 可靠性常识	(315)
9.1.3 平均无故障工作时间 (MTBF)	(319)
9.2 产品的生产过程和全面质量管理	(320)
9.2.1 产品生产过程中的几个阶段	(320)
9.2.2 生产过程中的质量管理	(320)
9.2.3 生产过程中的可靠性保证	(322)
9.3 ISO 9000 系列国际质量标准	(323)
9.3.1 质量管理和质量保证标准的产生和制定	(323)
9.3.2 世界各国采用 ISO 9000 标准系列的情况	(330)
9.3.3 GB/T 19000 标准系列的组成和性质	(333)
9.3.4 实施 GB/T 19000 标准系列的意义	(334)
9.4 ISO 14000 系列环境标准	(336)
9.4.1 ISO14000 系列标准的产生与发展背景	(336)
9.4.2 我国对 ISO 14000 系列标准的反响	(337)
9.4.3 ISO 14000 标准的内容	(337)

9.4.4 ISO 14000 系列标准和我国现有环保标准的不同点	(337)
9.4.5 实施 ISO 14000 标准的意义	(338)
9.4.6 电子产品生产的污染防治问题	(339)
9.5 3C 强制认证	(339)
思考与习题	(340)
附录 A	(343)
附录 B	(345)
参考文献	(350)

第1章 电子工艺技术和工艺管理

1.1 工艺概述

1.1.1 工艺的发源与定义

工艺是生产者利用生产设备和生产工具，对各种原材料、半成品进行加工或处理，使之最后成为符合技术要求的产品的艺术（程序、方法、技术），它是人类在生产劳动中不断积累起来的并经过总结的操作经验和技能。

说到工艺，人们很自然会联想起熟悉的工艺美术品。对于一件工艺美术品来说，它的价值不仅取决于材料本身以及方案的设计，更取决于它的制作过程——制造者对于材料的利用、加工操作的经验和技能。古人常说“玉不琢，不成器”，这话生动地道出了产品制造工艺的意义。

显而易见，工艺发源于个人的操作经验和手工技能。但是在今天，仍然简单地从这个角度来理解工艺，则是很不全面的。我们知道，市场竞争、商品经济使现代化的工业生产完全不同于传统的手工业。如果说，在传统的手工业中，个人的操作经验和手工技能是极其重要的，是因为那时人们对产品的消费能力低下，材料的来源稀少或不易获得，产品的生产者是极少数人，生产的工具、设备和手段非常简陋，产品的款式、性能改变缓慢，生产劳动的效率十分低下，行业之间“老死不相往来”，学习操作技能和经验的方式是“拜师学艺”；那么可以说，在经济迅猛发展的当今世界，上面谈到的一切都已经不同了：新产品一旦问世，马上会成为企业家们关注的焦点，只要是具有使用价值、设计成功、能够获得丰厚利润的产品，立刻就会招来各方面的投资和大批量的生产，很快就将风靡全球，引发亿万人的消费需求和购买欲望，与其相关的产品也会成批涌现出来。制造工艺学已经作为中、高等工科专业院校普遍开设的必修课程，工程技术人员成了工业生产劳动的主要力量。在产品的生产过程中，科学的经营管理、先进的仪器设备、高效的工艺手段、严格的质量检验和低廉的生产成本成为赢得竞争的关键，时间、速度、能源、方法、程序、手段、质量、环境、组织、管理等一切与商品生产有关的因素变成人们研究的主要对象。所以，现代化工业生产的制造工艺，与传统的手工业生产中的操作经验和人工技能相比较，这两者之间已经有天壤之别了。

随着科学技术的发展，工业生产的操作者作为劳动主体的地位在获得增强的同时，也在一定的意义上发生了“异化”：生产者按照工艺规定的生产程序，只需要进行简单而熟练的操作——他们在严格缜密的工艺训练指导之下，每一个操作动作必须是规范化的；或者，他们经验性的、技巧性的操作劳动被不断涌现出来的新型机器设备所取代。

在英语中，传统的手工工艺是 *handicraft*，工艺美术是 *arts and crafts*，而现代化的工业生产工艺是 *industrial process* 或 *technological process*。这两者的含义是截然不同的：前者具有“技巧”、“手艺”和操作者的“灵感”或“经验”的意思，而后者则强调突出了科学技术和工业化生产的整个过程。在国家技术监督局颁布的中华人民共和国国家标准 GB/T 19000—2000 (idt

ISO 9000: 2000) 系列标准《质量管理体系标准》中，不再将 process 译成“工序”或“工艺”，而统一译为“过程”，它的定义是：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源（可以包括人员、资金、设备、技术、方法）和活动。事实上，这不仅仅是个翻译技巧问题。《牛津现代高级英汉词典》中对 process 的解释为：

- ① 相互关联的一系列的活动、经过、过程；
- ② 一系列审慎采取的步骤、手续、程序；
- ③ 用于生产或实业中的方法、工序、制法。

显然，对于现代化的工业产品来说，工艺不再仅仅是针对原材料的加工或生产的操作而言，应该是从设计到销售、包容每一个制造环节的整个生产过程。

对于工业企业及其产品来说，工艺工作的出发点是为了提高劳动生产率，生产优良产品以及增加生产利润。它建立在对于时间、速度、能源、方法、程序、生产手段、工作环境、组织机构、劳动管理、质量控制等诸多因素的科学的研究之上。工艺学的理论研究及应用指导企业从原材料采购进厂开始，加工、制造、检验的每一个环节，直到成品包装、入库、运输和销售（包括销售活动中的技术服务及用户信息反馈），为企业组织有节奏的均衡生产提供科学的依据。可以说，工艺是企业科学生产的法律和法规，工艺学是一门系统性的科学。

自从工业化以来，各种工业产品的制造工艺日趋完善成熟，成为专门的学科，并在工科大、中专院校作为必修课程。例如切削工艺学，是研究用金属切削工具借助机器设备，把各种原材料或半成品加工成符合技术要求的机械零件的工艺过程。又如电机工艺学，是以电磁学为理论基础，研究各种发电机、电动机的制造技术。还有各种化工工艺学、纺织工艺学、焊接工艺学、冶金工艺学、土木工程学等。

电子产品的种类繁多，主要可分为电子材料（导线类、金属或非金属的零部件和结构件）、元件、器件、配件（整件）、整机和系统。其中，各种电子材料及元器件是构成配件和整机的基本单元，配件和整机又是组成电子系统的基本单元。这些产品一般由专业分工的厂家生产，必须根据它们的生产特点制定不同的制造工艺。同时，电子技术的应用极其广泛，产品可以分为计算机、通信、自动控制、仪器仪表等几大类，根据工作方式及使用环境的不同要求，其制造工艺又各不相同。所以，电子工艺学实际上是一个涉猎极其广泛的学科。

1.1.2 电子工艺学的特点

电子工艺学是一门在电子产品设计和生产中起着重要作用的而过去又不受重视的技术学科。随着信息时代的到来，人们认识到，没有先进的电子工艺就制造不出高水平、高性能的电子产品。因此，在我国的许多高等学校中相继开设了电子工艺课程。

作为一门与生产实际密切相关的技术学科。电子工艺学有着自己明显的特点，归纳起来主要有如下几点。

① 涉及众多科学技术学科。电子工艺与众多的科学技术学科相关连，其中最主要的有应用物理学、化学工程技术、光刻工艺学、电气电子工程学、机械工程学、金属学、焊接学、工程热力学、材料科学、微电子学、计算机科学等。除此之外，还涉及企业的财务、管理等众多学科。这是一门综合性很强的技术学科。

② 形成时间较晚，发展迅速。电子工艺技术虽然在生产实践中一直被广泛应用，但作为一门学科而被系统研究的时间却不长。系统论述电子工艺的书籍不多，20世纪70年代初第一

本系统论述电子工艺的书籍才面世，20世纪80年代初在高等学校中才开设相关课程。随着电子技术的飞速发展，对电子工艺提出了越来越高的要求，人们在实践中不断探索新的工艺方法，寻找新的工艺材料，使电子工艺的内涵及外延迅速扩展。可以说，电子工艺学是一门充满蓬勃生机的技术学科。

③ 实践性强。电子工艺的概念贯穿于电子产品的设计、制造过程，与生产实践紧密相连。所以，在高等工科院校开设的电子工艺课程中，实践环节是极其重要的，是相关专业能否培养出合格的工程师的关键。我们以往强调的培养学生动手能力的问题，在电子工艺课程中得到具体的体现。

④ 电子工艺学科的技术信息分散，获取难度大。由于电子工艺涉及众多技术学科。相关的技术信息分散在这些众多的学科中，电子工艺学与这些学科的关系是相辅相成的，成为技术诀窍（know how）密集的学科，所以，作为电子工艺工程师，对知识面、实践能力都有比较高的要求，也就是通常所说的复合型人才。当今的世界已进入知识经济的时代，大到一个国家，小到一个公司，对技术关键的重视程度都很高，技术封锁也是严密的。所以，技术关键的获取是非常困难的。

本书的任务，在于讨论电子整机（包括配件）产品的制造工艺。这是由于，对于大多数接触电子技术的工程技术人员以及广大业余爱好者来说，主要涉及到的是这类产品从设计开始，在试验、装配、焊接、调整、检验方面的工艺过程，对于各种电子材料及电子元器件，则是从使用的角度讨论它们的外部特性及其选择和检验。在本书后面的讨论中，凡说到“电子工艺”，是指电子整机产品生产过程方面的内容。

就电子整机产品的生产过程而言，主要涉及两个方面：一方面是指制造工艺的技术手段和操作技能，另一方面是指产品在生产过程中的质量控制和工艺管理。我们可以把这两方面理解为“硬件”和“软件”之间的关系。显然，对于现代化电子产品的大批量生产和高等院校工科学生今后在生产中承担的职责来说，这两方面都是重要的，是不能偏废的。本书对这两方面的内容都进行了比较详细的叙述。

1.1.3 我国电子工艺现状

由于我国工业水平起点较低，各种制造工艺学也比较落后。20世纪50年代，我国工程技术人员到国外（主要是前苏联和东欧各国）学习工业产品的制造工艺，各大专院校开始设置相应的工艺学课程，为这些工程技术的教育、普及、研究、发展打下了良好的基础。

在建国之初，我国工业处于百废待兴的发展阶段，各行各业的技术竞赛和技术交流十分广泛，涌现出一大批人们熟悉的全国劳动模范。他们在自己平凡的工作岗位上，刻苦钻研新的工艺技术和操作技能，为我国的工业进步做出了重要的贡献。例如，当年只有十八岁的上海德泰模型工场学徒工倪志福，针对使用工具钢麻花钻头在合金钢上钻孔经常烧毁的现象，不断摸索，总结经验，发明了普通钻头的特殊磨制方法，使工作效率提高了几十倍。用这种方法磨制的钻头被称为倪志福钻头，蜚声海内外；经过我国金属切削专家多年的分析研究，于20世纪60年代初向全世界公布了倪志福钻头的切削机理，同时还推出了适合在各种不同材料上钻孔的钻头磨制标准。直到现在，倪志福钻头还在金属机械加工中普遍应用。是否会磨制这种钻头，已经作为考核机械技术工人技能的基本试题。

电子工业是在最近几十年里才发展起来的新兴工业，在日本、美国等工业发达国家中（也

可以说在全世界的范围里), 电子工业发展的速度之快, 产品市场竞争的激烈程度, 都是前所未有的。各个厂家、各种产品的制造工艺一般都相互保密, 对外技术转让一般都有所保留。等到我国经济从 20 世纪 70 年代末期开始改革时, 电子工业已经与国际水平相差十分悬殊, 电子产品制造工艺学的研究基本上处于空白状态, 工科大专院校普遍缺乏电子工艺学教育, 派往国外的留学进修人员也由于技术保密而一般不能进入工程关键部门学习。我国传统的教育观念及经济体制也使电子工艺学的宣传教育十分薄弱, 各行业企业之间的工艺交流很少开展。

从建国之初到 21 世纪的今天, 我国的电子工业从无到有, 发生了巨大的变化。当年仅有几家无线电修理厂, 发展到今天, 已经形成了门类齐全的电子工业体系。在第一个五年计划期间, 国家投入大量资金, 在北京东郊地区建起了一批大型电子骨干企业, 对带动全国电子工业的发展起到了重要的作用。这片规模宏大的电子城, 曾经是新中国电子工业的象征和骄傲。现在, 几十年过去了, 中国的电子工业历经了改革开放的洗礼、资产重组的调整、商业经济的冲击, 发生了巨大的变化。电子产品制造业的热点转移到东南沿海地区。从宏观上看, 世界各工业发达国家和港台地区的电子厂商纷纷把工厂迁往珠江三角洲和长江三角洲, 这里制造的电子产品行销全世界, 中国成为世界电子工业的加工厂已见端倪; 但在某些原来电子工业基础较好的城市和地区, 电子产品制造企业的发展和生存却举步维艰, 很少有技术先进、能够大批量生产的产品, 缺乏稳定的工艺技术队伍。所以, 就我国电子产品制造业的整体上来说, 虽然不断从发达国家引进最先进的技术和设备, 却一直未能形成系统的、现代化的电子产品制造工艺体系。我国电子行业的工艺现状是“两个并存”: 先进的工艺与陈旧的工艺并存, 引进的技术与落后的管理并存。

由于以上原因, 就造成了这样的结果: 很多产品在设计时的分析计算非常精确, 实际生产出来的质量却很差, 性能指标往往达不到设计要求或者很不稳定; 有些产品从图纸到元器件全部从发达国家引进, 而生产出来的却比“原装机”的质量差, 实现国产化困难; 相当多的电子新产品的“设计”还只是停留在仿造国外产品的水平上, 对于设计机理的研究以及如何根据国内实际工艺条件更新设计的工作却没有很好地落实; 在有些小厂或私营企业中, 缺乏必要的技术力量, 完全没有实现科学的工艺管理, 工人照着“样板”或“样机”操作, 还停留在“小作坊”的生产方式中。

事实是, 国内外或者国内各厂家生产的同类电子产品相比, 它们的电路原理并没有太大的差异, 造成质量水平不同的主要原因存在于生产手段及生产过程之中, 即体现在电子工艺技术和工艺管理水平的差别上。在我国经济比较发达的沿海城市, 或者工艺技术力量较强、实行了现代化工艺管理的企业中, 电子产品的质量就比较稳定, 市场竞争力就比较强。同样, 对于有经验的电子工程技术人员来说, 他们的水平主要反映在设计方案时充分考虑了加工的可能性和工艺的合理性上。

众所周知, 二十多年以来的经济改革, 使我国的电子工业走上了腾飞之路。但迄今为止, 我国大部分大、中型工业企业的经济体制转轨尚未结束, 管理机制转变的痛苦既是不可避免的, 也给工艺技术的发展进步造成了一些负面的影响。近年来, 原来的国营大、中型企业纷纷划小核算单位, 使工艺技术人员和工艺管理人员的流失成为比较普遍的现象; 对于那些工艺技术及管理本来就很落后的小型工厂或私营企业, 市场的剧烈波动、产品的频繁转向使之无暇顾及工艺问题, 工艺技术落后、工艺管理混乱、工艺纪律不严和工艺材料不良的情况以及假冒伪劣的产品常有发生。但是应该相信, 一旦企业度过了经济改革的困难阶段、建立起科

学的管理机制，就需要一大批懂得现代科学理论的工艺技术人员；特别是在我国已经成为世界贸易组织成员的今天，贯彻 ISO 9000 质量管理体系标准、推行 3C 认证（中国强制认证，China Compulsory Certification，缩写 CCC）已经成为我国一项重要的技术经济政策，加强电子工艺学的普及教育，开展电子产品制造工艺的深入研究，对于培养具有实际工作能力的工程技术人员和工艺管理人员，对于我国电子工业赶超世界先进水平，其意义及重要性是显而易见的。

在经济飞速发展的今天，全世界进入了后工业化时代，在工业产品的制造过程中，科学的管理成为第一要素，缜密而有序的工艺控制、质量控制成为生产组织的灵魂。研究并推广现代化的工艺技术，已经成为工程技术人员的主要职责。

1.1.4 电子工艺学的教育培训目标

应该说，“电子技术应用”是我国工科院校的一门传统专业，但就一般毕业生来说，他们在校期间学习的知识内容与实际工作的需求差距很大，这不仅因为高校普遍追求培养研究型人才，还因为我们的教育似乎总是落后于社会的需求。这里不仅有教学安排与教材相对落后于实际技术发展的原因，还与目前高校工程工艺实训环境和设备条件的限制有关。在很多高等院校里，只能进行低水平的、与中等技术学校没有什么差别的“电子实训”。诚然，让电子类工科学生参加足够学时的生产实习、操作实训是极其重要的：如果他们不了解电子产品生产过程的每一个细节，不理解生产工人操作的每一个环节，就很难设计出具有生产可行性的产品。日本丰田汽车的创始人丰田喜一郎有一句名言：“技术人员不了解现场，产品制造就无从谈起。”他的这一观点，应该成为每一个电子工程技术人员的座右铭。毫无疑问，对电子工艺技术的真知灼见将有助于原理性设计的成功。但是这还不够，成功的原理性设计并不等于高质量的大批量生产，现在的电子制造企业更希望我们的工科毕业生能从技术管理者的角度来认识生产制造过程。

电子工艺技术的教育培训目标是：针对国内高等院校电子类专业教学实践的现状，从人才市场的需求出发，系统培养电子产品制造技术的高级专业人才。在课程设置和实训环节的安排方面，不仅培养学生掌握电子产品生产操作的基本技能，充分理解工艺工作在产品制造过程中的重要地位，还要求他们能够从更高的层面了解现代化电子产品生产的全过程，认识目前我国电子产品生产中最先进的技术和设备。也就是说，要适应现代化和工业化对工程技术人才培养的需求，为电子产品制造业培养一批高层次的、特别是那些能够在电子产品制造现场指导生产并解决实际问题的工艺工程师和高级技师。

1.2 电子产品制造工艺工作程序

1.2.1 电子产品制造工艺工作程序图

电子产品制造工艺工作程序是指产品从预研制阶段、设计性试制阶段、生产性试制阶段，直到批量性生产（或质量改进）的各阶段中有关工艺方面的工作规程。工艺工作贯穿于产品设计、制造的全过程。

图 1-1 是电子工业产品工艺工作程序图。从图中可以看出，电子产品工艺工作的流程路径、审批过程及信息反馈的关系，这是一个“闭环”的控制网络和管理系统。

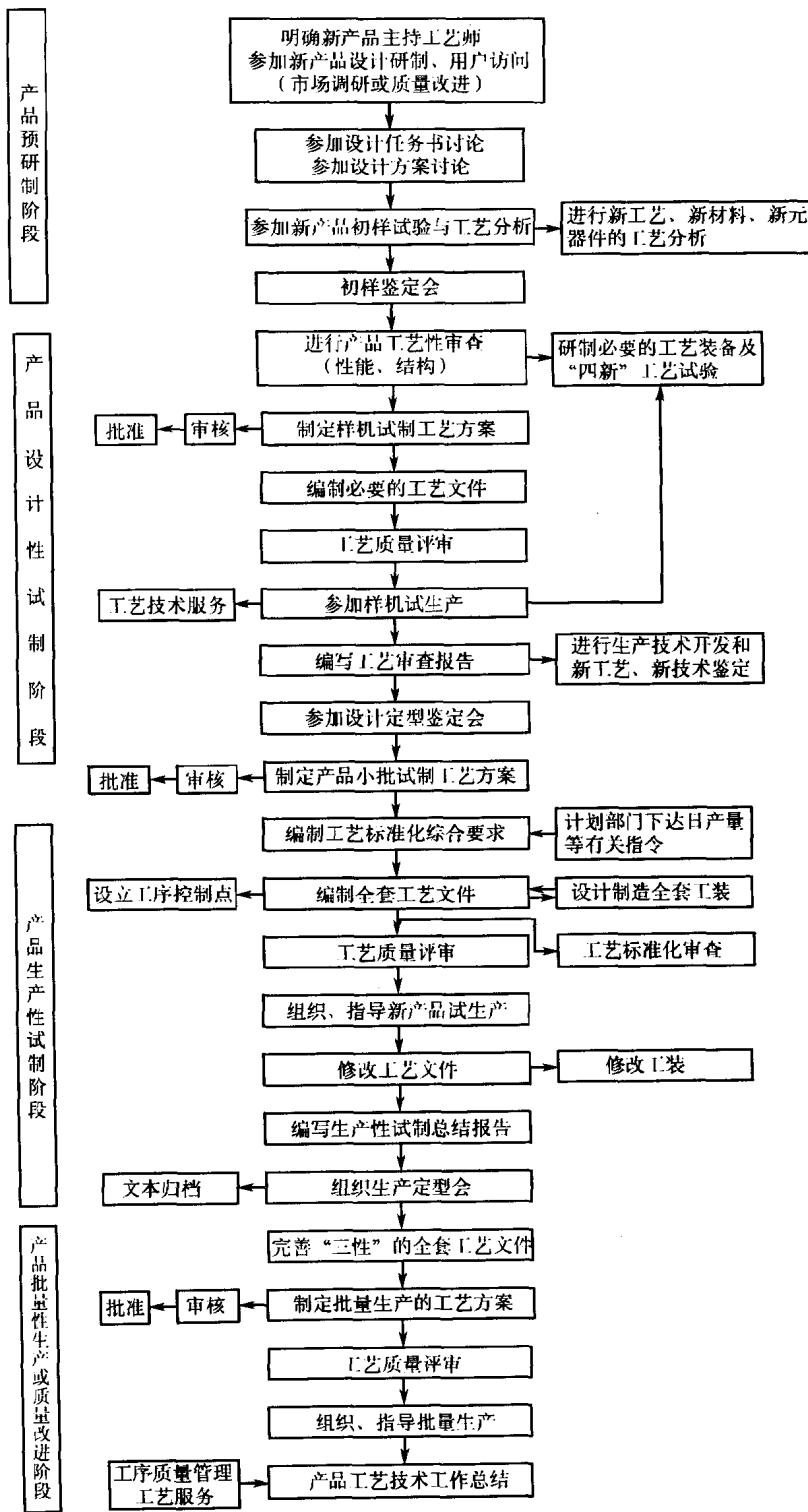


图 1-1 电子产品制造工艺工作程序图